

导热双面胶带 XK-TN08P

XK-TN08P 导热双面胶带是一种耐高温丙烯酸酯压敏胶填充高导热陶瓷涂布于高绝缘导热 POLYIMIDE 两面而制成。XK-TN08P 具有一般导热性及超高粘接性能，使其电子器件与散热器之间不再需要机械扣具和胶粘剂固定。

XK-TN08P 导热双面胶带使用时只需轻压即可立即粘接，其粘接性能、粘接强度随时间和温度和施加压力升高而增强。

XK-TN08P 导热双面胶带含导热 POLYIMIDE,尺寸安定可模切任何形状的产品，并可以预先贴在一个表面上以便将来贴合使用。



可取代 Bergquist Bondply660P

	unit	XK-TN08P	Method
Reinforcement Carrier		Polyimide	
Color		Light Brown	visual
Thickness	mm	0.1	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm ³	1.4	ASTM D792
Bonding strength	N/in	>10	ASTM 3330
Thermal impedance	°Cin ² /W	0.79	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	> 1.0	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV	6.0	ASTM D149
Dielectric Constant	1	5	ASTM D150
Application temperature	°C	-30~130	
Tensile strength	psi	>5000	ASTM D149
Elongation	%	20	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	0	GC-FID